

STMicroelectronics propose de réaliser des prototypes de circuits MEMS hautes performances par l'intermédiaire du CMP

Cette initiative favorisera le développement de nouvelles applications dans le domaine de la détection de mouvements

Genève, Suisse, et Grenoble, France, le 19 mars 2013 — STMicroelectronics (NYSE : STM) et CMP (Circuits Multi-Projets®) annoncent ce jour que THELMA, la technologie de fabrication de MEMS de ST que la Société utilise pour ses accéléromètres et gyroscopes leaders sur le marché livrés à plusieurs milliards d'unités¹, est à présent mise à la disposition des universités, des laboratoires de recherche et des entreprises de conception aux fins de prototypage par le biais des services de courtage de CMP. ST fournit cette technologie de fabrication à des tierces parties sous la forme de services de fonderie et de prototypage pour encourager de nouveaux développements dans les applications de détection de mouvements sur les marchés grand public, de l'automobile, de l'industrie et de la santé.

Le succès remporté de longue date par ST dans le domaine des capteurs MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) repose sur les processus de fabrication de pointe développés par la Société. La technologie de micro-usinage en surface en géométrie de 0,8 micron THELMA (Thick Epitaxial Layer for Microgyroscopes and Accelerometers) associe des couches de silicium polysilicium d'épaisseur et de finesse variables pour les structures et les interconnexions. Cette technique permet d'intégrer des éléments mécaniques linéaires et angulaires dans un unique circuit intégré, avec à la clé des avantages de coûts et de dimensions significatifs pour les clients.

Le service multi-projets sur tranches silicium de CMP permet aux entreprises de réaliser des circuits intégrés avancés en petites quantités, typiquement entre quelques douzaines et quelques milliers d'unités, en utilisant les mêmes technologies de fabrication que pour fabriquer des produits dans des quantités nettement supérieures. Les règles de dessin et les kits de conception de la technologie THELMA sont mis à la disposition des universités et des entreprises de microélectronique, et les premières demandes sont actuellement traitées.

L'introduction de la technologie de fabrication de MEMS de ST dans le catalogue de CMP capitalise sur la collaboration fructueuse qui a permis à des universités et des entreprises de conception d'accéder aux technologies de fabrication de semiconducteurs de ST, depuis la technologie CMOS en 130 nm introduite en 2003 jusqu'à la technologie FD-SOI (silicium sur isolant – entièrement déplété) de 28 nm, mise à disposition pour prototypage fin 2012. Cette approche assure la conception efficace de produits mobiles de nouvelle génération qui requièrent simultanément des performances élevées et une faible consommation d'énergie.

¹ ST est le premier fabricant mondial de MEMS avec des livraisons cumulées de plus de trois milliards de composants et une capacité de production de 4 millions d'unités par jour. Selon le cabinet Yole Développement, ST est la première entreprise à avoir atteint un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars pour la vente de MEMS.

« La disponibilité à petite échelle de notre technologie de fabrication de MEMS, parallèlement aux technologies CMOS et à la toute nouvelle filière révolutionnaire FD-SOI que complètent les services avancés proposés par CMP, assure aux start-ups et aux laboratoires de R&D qui souhaitent concevoir des systèmes à base de capteurs intelligents un accès sans précédent à l'état de l'art dans le domaine de la fabrication de circuits intégrés », a déclaré Benedetto Vigna, executive vice-president et directeur général du groupe MEMS, Capteurs & Produits Analogiques de ST. « En disposant de processus industrialisés à la pointe de la technologie, les sociétés innovantes peuvent se concentrer sur le développement de nouveaux produits au lieu d'investir du temps et des ressources dans le développement de technologies. »

« Anticipant d'importants développements dans les MEMS, CMP a été le premier service de courtage en circuits intégrés à proposer des technologies MEMS dès 1995 », a déclaré Bernard Courtois, Directeur de CMP. « Aujourd'hui, CMP élargit son partenariat fructueux avec ST à la technologie THELMA pour offrir à la fois la partie CMOS et la partie MEMS auprès d'un unique fabricant. Au-delà des centrales inertielles, des capteurs de pression, des microphones et des boussoles électroniques, le partenariat ST-CMP permettra aux clients de CMP d'évoluer vers des systèmes embarqués complexes afin de répondre à un éventail de plus en plus large de besoins sociétaux, parmi lesquels l'Internet des Objets. »

Les perspectives des systèmes intelligents pour l'Internet des Objets ont été présentées par Benedetto Vigna, à l'occasion de son intervention prononcée dans le cadre de la conférence DATE (Design, Automation & Test in Europe) qui a lieu à Grenoble (www.date-conference.com).

À propos de STMicroelectronics

ST est un leader mondial sur le marché des semi-conducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power, les produits pour l'automobile et les solutions de traitement embarquées. De la gestion de la consommation aux économies d'énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « [life.augmented](#) ».

En 2012, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,49 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

A propos de CMP

Le CMP est un courtier en circuits intégrés et en MEMS (microsystèmes électromécaniques) pour les besoins du prototypage et de la production à petits volumes. Les circuits sont fabriqués pour les universités, les laboratoires de recherche et les sociétés industrielles. Des technologies industrielles avancées sont disponibles pour les filières CMOS, BiCmos, BiCMOS SiGe, tensions élevées, FD-SOI jusqu'à 20 nm, AsGa pHEMT, MEMS, etc. CMP distribue et prend en charge plusieurs logiciels de CAO pour les sociétés industrielles et les universités. Depuis 1981, plus de 1.000 institutions réparties dans 70 pays ont été servies, plus de 6.000 projets prototypés à travers 700 essais, et 60 technologies différentes mises

en interface. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur <http://cmp.imag.fr>. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur <http://cmp.imag.fr>.

Contacts presse

STMicroelectronics

Pascal Boulard

Tél : 01.58.07.75.96

Mobile : 06.14.16.80.17

pascal.boulard@st.com

CMP

Bernard Courtois

+33 4 76 57 46 15

Bernard.Courtois@imag.fr